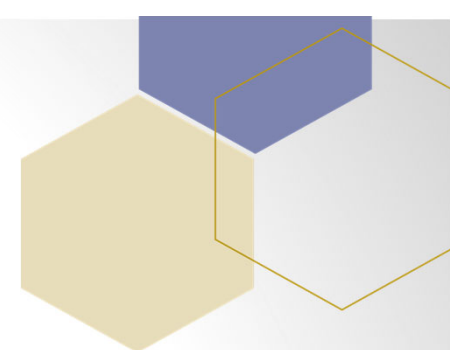





2020年3月期 決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

証券コード:4973

2019年10月23日



2020年3月期 第2四半期の概況

電子部品業界の状況

- ハイエンドスマートフォンの更なる高機能化、高価格の見直しなどがあつた。
- 昨年からの半導体及び電子部品の在庫調整の動きは一段落したように見受けられるが、米中貿易戦争、日韓関係悪化などもあり、原料薬品メーカーへの影響が出るかを含め不透明感がある。

当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売は堅調だが、米中貿易戦争や日韓関係悪化に伴う在庫積上げ要請の影響もあり実需が不透明である。
- コネクタ用めっき薬品の販売は、ユーザーの高機能スマートフォンへの過度の依存からの脱却の動きと当社の改良しためっき薬品投入の効果もあり順調に推移した。
- リードフレーム用めっき薬品の販売は、半導体需要の低迷により低調であつたが、前事業年度から続く貴金属パラジウム価格の高止まりに伴い引き続き販売額が増加する結果となつた。
- 輸出地域別ではタイ、ベトナム地域での拡販が進み順調に推移した。

2020年3月期 第2四半期決算概況

(単位:百万円、%)

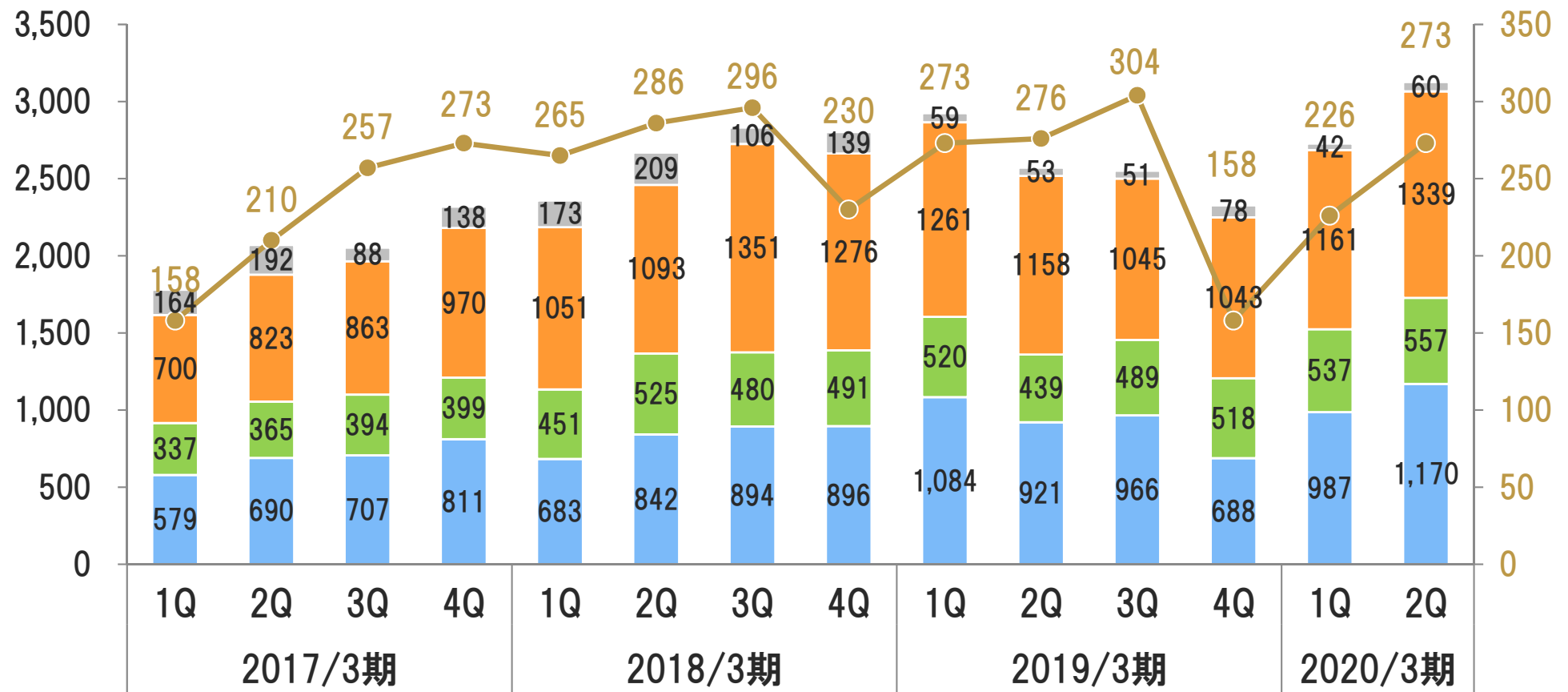
	2019/3期 1Q~2Q	2020/3期				2020/3期予想	
		1Q	2Q	1Q~2Q	増減率		達成率
売上高	5,498	2,728	3,128	5,857	6.5	10,500	55.8
営業利益	550	226	273	499	△9.2	1,000	50.0
経常利益	626	284	279	564	△9.8	1,120	50.4
純利益	455	212	203	416	△8.6	780	53.4
1株当たり 当期純利益	79.02円	36.82円	35.28円	72.10円	—	135.15円	—

売上高・営業利益の推移(四半期ベース)

(百万円)

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクター・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他
- 営業利益

(百万円)

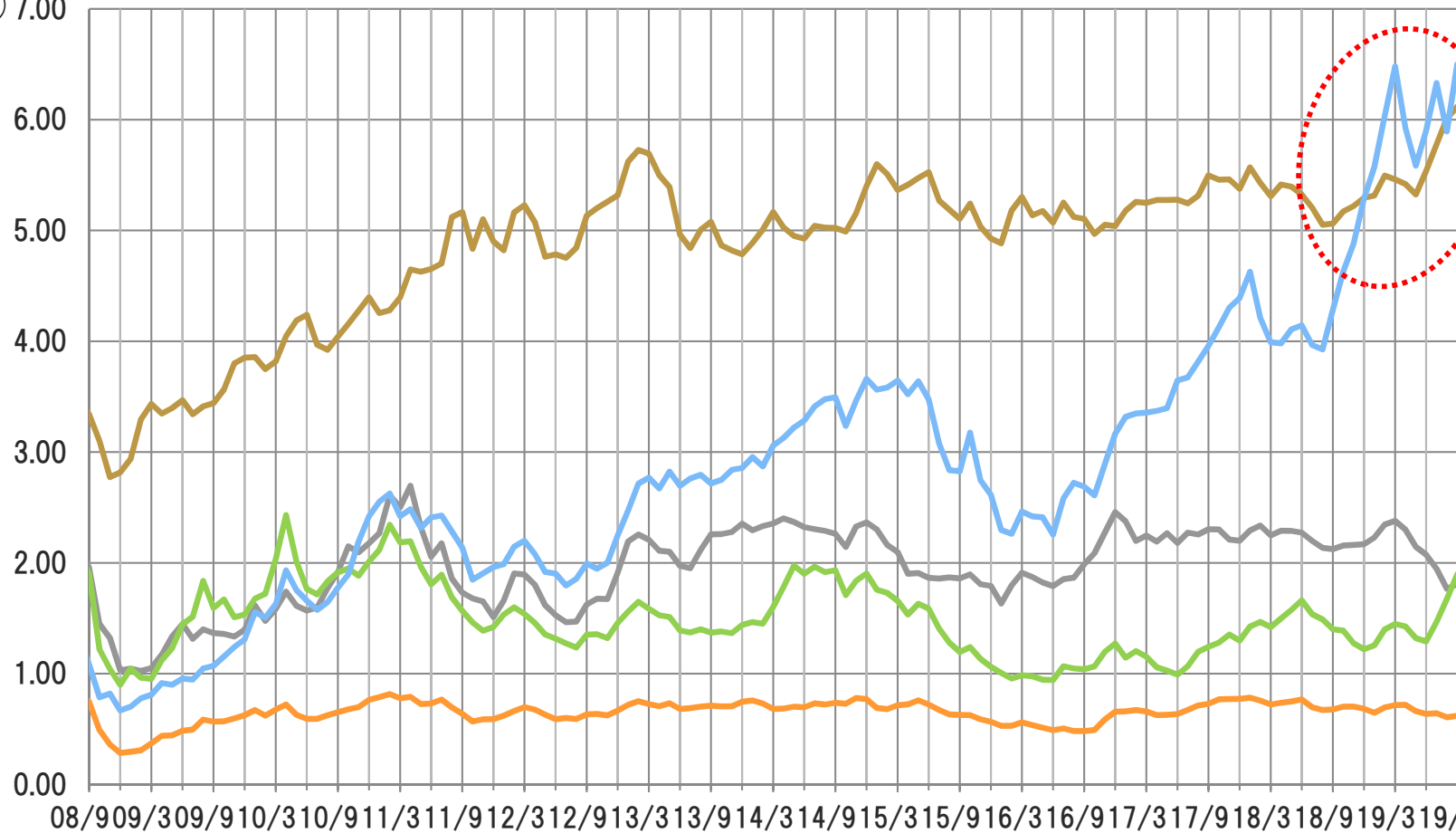


メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

■ Copper 銅
■ Tin スズ
■ Nickel ニッケル

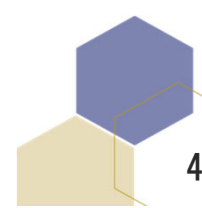
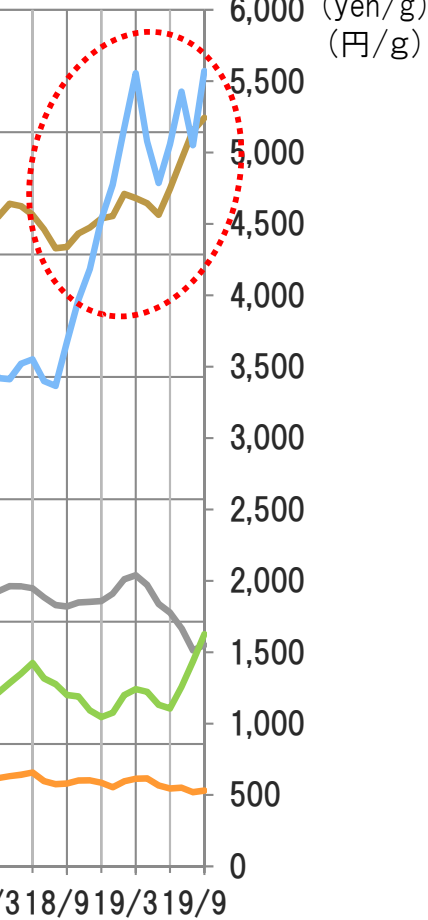
(yen/g)
(円/g)



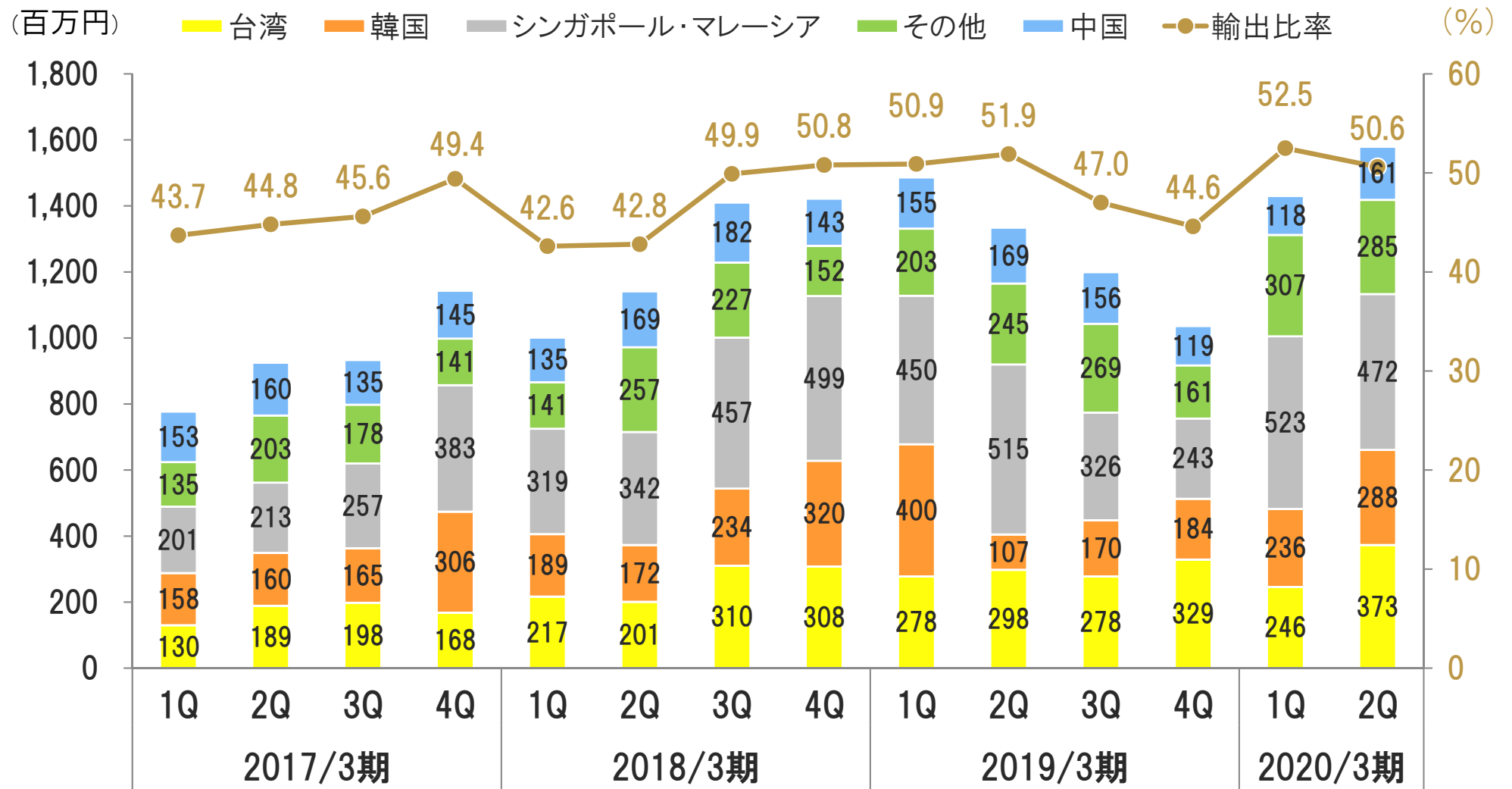
Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

■ Gold 金
■ Palladium パラジウム

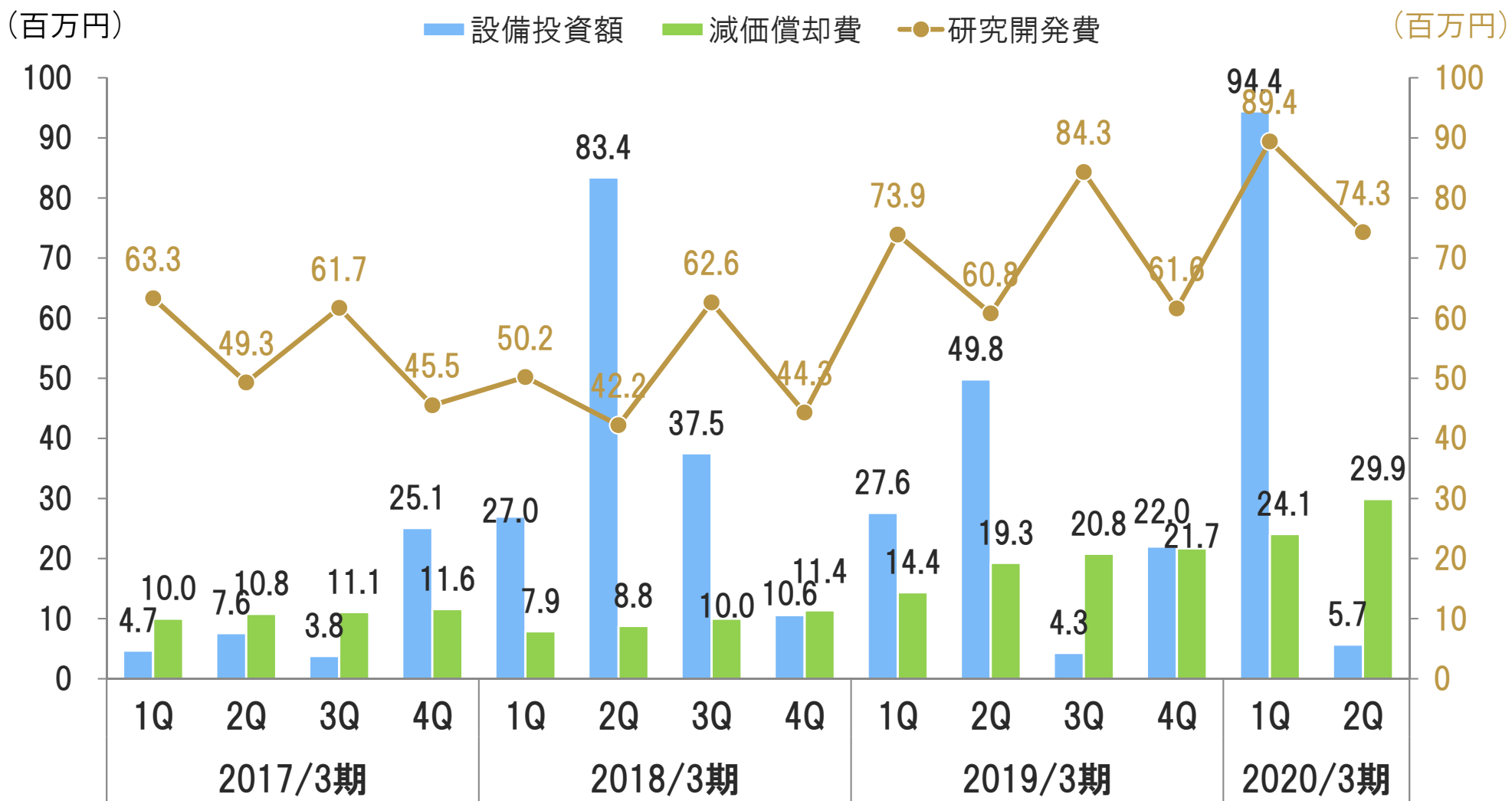
(yen/g)
(円/g)



輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



配当政策およびESG情報

1株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS	配当性向
2016/3期	80	121.31	65.9
2017/3期	80	124.44	64.3
2018/3期	80	144.13	55.5
2019/3期	80	146.36	54.7
2020/3期(予想)	80	135.15	59.2

ESGに関する取り組み

- **環境配慮**・・・限られた貴金属資源の有効利用のため、省金製品を顧客に訴求
- **社会貢献**・・・学生の奨学援助を目的にJPC奨学財団を設立(2019年2月)
- **ガバナンス強化**・・・取締役会の下に指名報酬諮問委員会を設置(2019年6月)

通期の見通し

(単位:百万円、%)




	2019/3期			2020/3期		
		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	10,380	100.0	△2.7	10,500	100.0	1.1
営業利益	1,013	9.8	△6.1	1,000	9.5	△1.3
経常利益	1,155	11.1	△2.1	1,120	10.7	△3.1
当期純利益	844	8.1	1.8	780	7.4	△7.6

トピックス

- 硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっきの改良製品を投入し拡販中
- ENIG(置換金)**・・・電子部品の世界の工場として伸長する東南アジア市場にて需要拡大
- DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。

製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

めっき方式		用途	製品ラインアップ
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7
	電解Pd		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき IM-GOLD IB2X 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP
新分野			卑金属(銅、スズ、ニッケル) 合金めっき 後処理剤など

今後の展開

① 当社貴金属めっきシェアを拡大



新用途のキャッチアップ

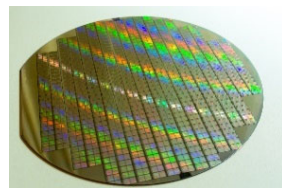
② 当社があまり手を付けてこなかった 貴金属めっき市場を開拓



海外車載コネクタ需要のキャッチアップ

③ 半導体・先端パッケージ開発に対応する めっき技術への挑戦

★ 貴金属めっきで培ったユニークな技術を他のめっき技術に展開



有機基板から
ウェハー、先端パッケージへ



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2019年9月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に指定
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき工程に絞り世界シェアトップ
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献